

R&D 神戸製鋼技報掲載 電子・電気材料／機能性材料および装置関連文献一覧表

(Vol.55, No.1～Vol.65, No.1)

Papers on Advanced Technologies for Electronic and Electric technologies (Advanced Materials and Apparatuses) in R&D Kobe Steel Engineering Reports (Vol.55, No.1～Vol.65, No.1)

	巻／号
●Liイオン二次電池における充放電Li輸送と劣化現象のモデル解析……………山上達也 ほか	64/2
Modeling Li Transportation and Degradation Phenomena of Li-ion Secondary Batteries	Dr. Tatsuya YAMAUE et al.
● μ -PCD法による酸化物半導体薄膜の評価装置 – 計測技術の有効性 – ……………野々村勇希 ほか	64/2
Evaluation System for Thin-Film Oxide Semiconductor Using μ -PCD – Effectiveness of Measuring Technique	Yuki NONOMURA et al.
●PITS測定とデバイスシミュレーションによる酸化物半導体TFTの特性解析……………田尾博昭 ほか	64/2
TFT Characteristic Analysis by PITS Measurement and Device Simulation	Hiroaki TAO et al.
●貼り合わせウェーハのずれ測定法……………古田洋平 ほか	64/2
Method for Measuring Shift of Bonded Wafers	Yohei FURUTA et al.
●サファイアウェーハ向けエッジロールオフ測定装置……………妹尾和宜 ほか	64/2
Edge Roll-off Measuring System for Sapphire Wafers	Kazuyoshi SENOO et al.
●耐応力緩和特性を強化した端子用銅合金CAC5……………野村幸矢	62/2
New Copper Alloy, CAC5, with Excellent Stress Relaxation Resistance for Automotive Electrical Connectors	Dr. Koya NOMURA
●コネクタ用錫めっき銅合金板条の性能向上技術……………鶴 将嘉 ほか	62/2
Technology for Improving the Performance of Tin Plated Copper Alloy for Connectors	Masahiro TSURU et al.
●端子用Cu-(Ni, Co)-P系合金の強度と導電率に及ぼす時効条件の影響……………宍戸久郎 ほか	62/2
Effect of Aging Conditions on Hardness and Electrical Conductivity in Cu-(Ni,Co)-P Alloys for Connectors	Hisao SHISHIDO et al.
●高強度銅Cu-Sn-P合金の動的再結晶に関する基礎研究……………渡辺雅人 ほか	62/2
Basic Study of Dynamic Recrystallization in Cu-Sn-P Alloy for High Strength Copper	Dr. Masato WATANABE et al.
●コーベホーネット [®] 構造体……………平野康雄 ほか	61/2
Integrated Application Method for KOBEHONETSU TM Steel Sheet	Dr. Yasuo HIRANO et al.
●純鉄系軟磁性材料の開発動向……………千葉政道	61/1
Development Trends of Soft Magnetic Iron	Dr. Masamichi CHIBA
●熱処理によるAuコーティングチタンセパレータの導電性向上……………佐藤俊樹 ほか	60/2
Improvement in Electrical Conductivity of Titanium Separator with Au Coating through Heat Treatment	Toshiki SATOH et al.
●低鉄損圧粉磁心用粉末……………北条啓文 ほか	60/2
Powder for Dust Core with Low Iron Loss	Hirofumi HOJO et al.
●硬質膜用PVDコーティング装置……………藤井博文 ほか	59/2
PVD Coating System for Hard Thin Film	Hirofumi FUJII et al.
●液晶パネル配線膜におけるダイレクトコンタクト対応Al合金の開発……………釘宮敏洋 ほか	59/1
Development of Al-alloy to Realize Direct Contacts with ITO and a-Si for TFT-LCD Interconnection	Toshihiro KUGIMIYA et al.

- ITER用Nb₃Sn素線 村上幸伸 ほか 59/1
Nb₃Sn Strands for ITER Yukinobu MURAKAMI et al.
- 電磁波減衰鋼板「コーベデンジシールド[®]」 平野康雄 ほか 59/1
Electromagnetic Wave Attenuation Steel Sheet KOBEDENJISHIELDTM Dr. Yasuo HIRANO et al.
- 高強度軟磁性材料の開発 千葉政道 59/1
Development of High Strength Soft Magnetic Steel Dr. Masamichi CHIBA
- 磁気ディスク基板用アルミニウム合金のめっき面平滑性におよぼす合金元素の影響 加藤良則 ほか 59/1
Influence of Alloying Elements on Plating Surface of Aluminum Alloy Substrate for Magnetic Memory Disk Yoshinori KATO et al.
- 車載半導体用リードフレーム銅合金板条 三輪洋介 ほか 59/1
Copper Alloy Strips for Lead-frames for Automotive Semiconductors Yosuke MIWA et al.
- 端子・コネクタ用電気すずめっき銅合金板条 真砂 靖 ほか 59/1
Tin Plated Copper Alloy Materials for Connectors Yasushi MASAGO et al.
- IT・電機機器用アルミニウム合金板の開発動向 小林一徳 58/3
Technical Trends in Aluminum Alloy Sheets and Plates for IT and Electric Instruments Kazunori KOBAYASHI
- 半導体・液晶製造装置用アルミニウム部材の技術動向 田中敏行 ほか 58/3
Technological Trend in Aluminum Parts Used for Semiconductor and LCD Manufacturing Apparatuses Toshiyuki TANAKA et al.
- 低摩擦抵抗・耐熱信頼性・はんだ濡れ性を備えた端子用錫めっき材 平 浩一 58/3
- 当社におけるPVD受託加工事業の概要と適用例 赤理孝一郎 58/2
Outline of PVD Job Coating Business and Applications in Kobe Steel Koichiro AKARI
- 縦型高分解能RBS分析装置 牟礼祥一 ほか 58/2
Vertical Type High Resolution RBS Analysis System Shoichi MURE et al.
- 小型・高機能ロールツーロールスパッタ装置 玉垣 浩 ほか 58/2
Compact and High Performance Roll to Roll Sputtering System Hiroshi TAMAGAKI et al.
- 光ファイバ線引装置と線引炉シミュレーション 若園武彦 ほか 58/2
Optical Fiber Drawing Machine and Simulation of Optical Fiber Drawing Furnace Takehiko WAKAZONO et al.
- 電磁波減衰鋼板「コーベデンジシールド[®]」 平野康雄 58/2
- 面法線方向測定を用いた新しいウェーハエッジの断面形状測定法 森本 勉 ほか 57/3
New Measurement Method for Cross-section of Wafer Edge Using Surface-normal Sensing Technique Tsutomu MORIMOTO et al.
- SPring-8 SR-XAFSを用いた鋼中Cu析出物の構造変化の解析技術 家口 浩 ほか 57/3
Technology to Observe Structural Change of Cu Precipitates in Steel Using SPring-8 SR-XAFS Dr. Hiroshi YAGUCHI et al.
- パウダー・イン・チューブ法によるTa添加Nb₃Sn高磁場用超電導線材の開発 財津享司 ほか 57/3
Development of (Nb, Ta)₃Sn Superconducting Wires for High Field Magnet Through Ta-Sn Powder in Tube Process Kyoji ZAITSU et al.
- ヘテロエピ・ダイヤモンド基板上に作製した高周波トランジスタの10GHz超動作の実証 横田嘉宏 ほか 57/3
Over 10GHz Operation of RF Transistors Fabricated on Heteroepitaxial Diamond Substrates Ph. D. Yoshihiro YOKOTA et al.
- 銅汚染の無いシリコンウェーハ再生技術の開発 鈴木哲雄 ほか 57/1
New Process for Reclaiming Test Wafers without Copper Contamination Dr. Tetsuo Suzuki et al.

- 低温ポリシリコンTFTプロセスにおける結晶欠陥の評価 – ライフタイム測定技術の応用 – 住江伸吾 ほか 57/1
Crystallinity Evaluation in Low-Temperature-Poly-Silicon TFT Manufacturing Process – Application of Lifetime Measurement –
Dr. Shingo Sumie et al.
- 液晶パネル配線膜におけるダイレクトコンタクト対応Al合金の開発 釘宮敏洋 ほか 57/1
Development of Al-Ni Interconnections for TFT-LCDs Using Direct Contacts with ITO and a-Si Toshihiro Kugimiya et al.
- プリント基板加工用アルミ表面潤滑処理材..... 吉川英一郎 ほか 57/1
Lubricant Pretreated Aluminum Sheet for Printed Wiring Board Drilling Eiichiro Yoshikawa et al.
- 無冷媒型超電導マグネット..... 広瀬量一 ほか 57/1
Cryogen-free Superconducting Magnet Ryoichi Hirose et al.
- 半導体リードフレーム用銅合金スーパーKFC シリーズおよびKLF170 尾崎良一 ほか 57/1
- 高機能電磁部品用純鉄系軟磁性材料..... 千葉政道 ほか 55/2
Soft Magnetic Iron for High Performance Electromagnetic Parts Dr. Masamichi Chiba et al.
- 放熱性鋼板「コーベホーネツ®」 平野康雄 ほか 55/2
KOBEHONETSU Heat Releasing Steel Sheet Yasuo Hirano, Ph. D. et al.
- 高容量磁気ディスク用アルミニウム合金基板..... 加藤良則 ほか 55/2
Aluminum Alloy Substrate for High Density Magnetic Memory Disks Yoshinori Kato et al.
- 電子・電気機器用銅合金及び空調用銅管の開発と将来動向..... 原 利久 ほか 55/2
Developments and Future Trends in Copper Alloy Strip for Electronic Equipment and in Copper Tube for Air Conditioner
Toshihisa Hara et al.
- PVD装置の開発と将来展望 高原一樹 ほか 55/2
Current and Future PVD Systems and Coating Technologies Kazuki Takahara et al.
- 高機能薄膜及びスパッタリングターゲット材料の開発..... 中井淳一 ほか 55/2
Development of Functional Thin Films and Sputtering Target Materials for Electronic Devices Dr. Junichi Nakai et al.
- 超電導製品の開発と将来展望..... 濱田 衛 ほか 55/2
Developments in Superconducting Wires and Magnets Dr. Mamoru Hamada et al.
- ダイヤモンド薄膜の微細加工技術..... 川上信之 ほか 55/1
Microfabrication of Diamond Thin Films Nobuyuki Kawakami et al.
- 光ディスク用高耐久性および高反射率Ag-Bi系合金反射膜の開発 高木勝寿 ほか 55/1
Development of Ag-Bi Alloy Reflective Films with Excellent Durability and High Reflectivity for Optical Discs Katsutoshi Takagi et al.
- リードフレーム用Cu-Fe-P系合金の軟化特性に及ぼす分散粒子量の影響 有賀康博 ほか 55/1
Effect of Dispersoids on Softening Behavior in Cu-Fe-P Alloys for Lead Frames Yasuhiro Aruga et al.
- 光干渉法によるウェーハの精密形状計測..... 森本 勉 ほか 55/1
Precise Measurement of Wafer Geometry Using Interferometric Methods Tsutomu Morimoto et al.
- 大立体角ラザフォードバックスキャタリング分析装置の開発..... 小林 明 ほか 55/1
Development of a New Spectrometer for Rutherford Backscattering Spectrometry Akira Kobayashi et al.